

定制Ptfе晶圆清洗篮 半导体硅晶圆支架 低本底氟聚合物卡匣

货号: PL-CP266



简介

用于半导体加工的高纯度定制PTFE晶圆清洗篮。这款定制氟聚合物卡匣专为低本底痕量分析设计，具备优异的耐强化学腐蚀性能，可在关键洁净室环境和工业实验室中实现零溶解，无污染处理硅晶圆。

[了解更多](#)

应用场景	说明	核心优势
RCA清洗 (SC-1/SC-2)	去除硅表面有机污染物、薄氧化层和离子杂质。	对过氧化氢和氢氧化铵混合液具备优异耐受性。
氢氟酸蚀刻	选择性去除二氧化硅层，完成表面钝化。	完全耐氢氟酸腐蚀，氢氟酸会腐蚀石英或玻璃载具，本产品不受影响。
食人鱼蚀刻工艺	使用硫酸和过氧化氢强力去除重有机残留物和光刻胶。	在强放热氧化环境中仍可保持结构完整。
光刻工艺支持	在光刻胶显影、去胶和漂洗过程中承载晶圆。	耐溶剂性确保载具接触去胶剂时不会膨胀或软化。
CMP后漂洗	化学机械平坦化后对晶圆进行关键清洗，去除研磨浆料。	低颗粒产生表面确保抛光后晶圆保持洁净。
化合物半导体制备	专门用于GaAs、GaN和InP晶圆清洗，用于先进光电器件生产。	精准开槽的 gentle 支撑可防止脆性化合物材料受损。
超声/兆声清洗	利用高频振动清洗，在去离子水中去除亚微米颗粒。	材料特性可抑制过度振动，同时保证有效能量传递。
参数类别	PL-CP266规格说明	
主体材料	高纯度PTFE (聚四氟乙烯) / PFA (全氟烷氧基烷烃)	
制造工艺	高精度CNC数控加工 (定制生产)	
晶圆尺寸兼容性	完全可定制 (常规尺寸: 2英寸、3英寸、4英寸、6英寸、8英寸、12英寸或定制尺寸)	
槽位配置	可根据工艺需求定制间距、深度和槽位数量	
提手设计	可选固定式、可拆卸式或一体式吊环 (可定制)	
耐化学腐蚀性	优异 (兼容所有酸、碱和有机溶剂)	
工作温度范围	-200°C 至 +260°C (材料极限，依应用场景调整)	
表面粗糙度	可控CNC加工光洁度，最大程度减少颗粒残留	
痕量元素本底	针对低水平痕量分析优化 (满足低本底需求)	
溶解特性	零溶解/无浸出添加剂 (无溶出)	